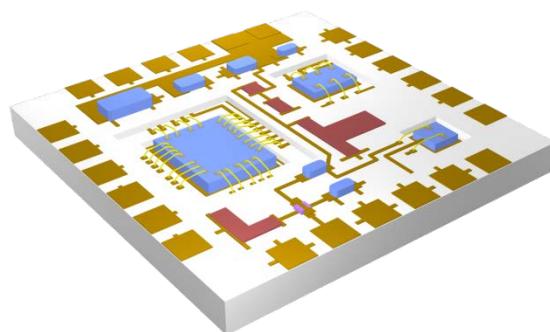




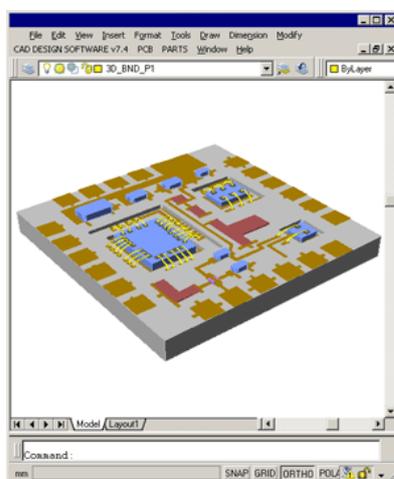
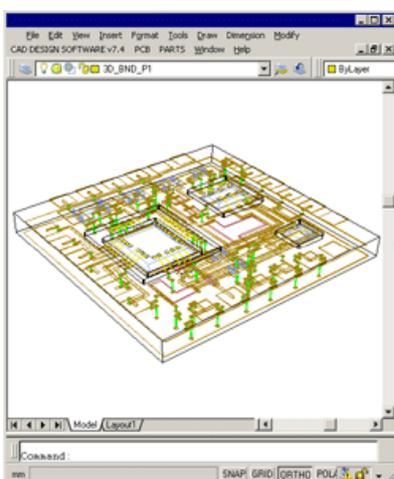
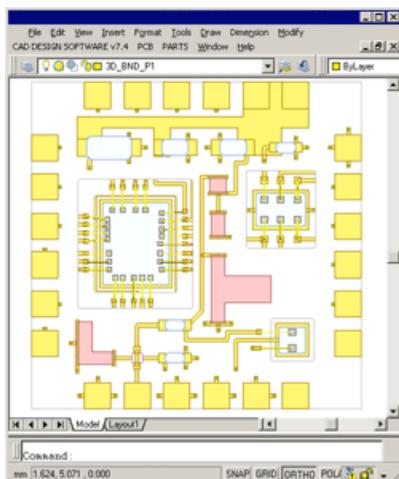
ООО "Евроинтех"
140011, Россия, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Телефон: +7-(495)-749-45-78
E-mail: sales@eurointech.ru
http://www.eurointech.ru/cds

CAD Design Software — программное обеспечение для проектирования керамических плат и многокристальных модулей

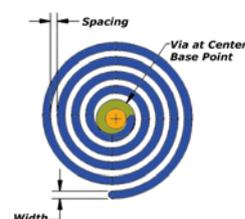
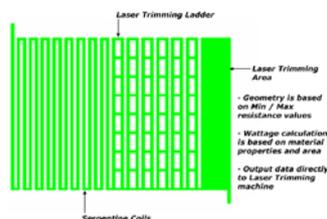
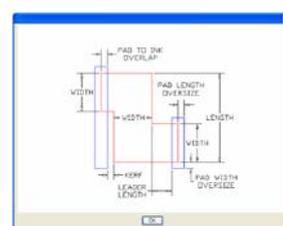
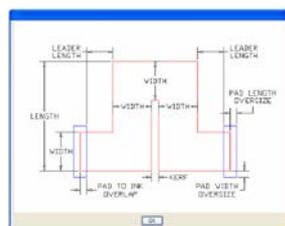
Пакет Master Ceramic Designer компании CAD Design Software представляет собой специализированное программное обеспечение, предназначенное для проектирования многокристальных модулей (MCM), включающих одно- и многоярусные стеки кристаллов, которые могут быть расположены на одной или двух сторонах подложки с произвольной конфигурацией встроенных пассивных и объемных элементов.



Пакет поддерживает разработку MCM модулей, выполненных на различных типах органических и керамических подложек (ламинатах, LTCC, HTCC, Thick Film Ceramic и Thin Film Ceramic) и перекрывает все необходимые этапы проектирования и подготовки производства. Проект может содержать неограниченное число слоев с каждой стороны подложки.

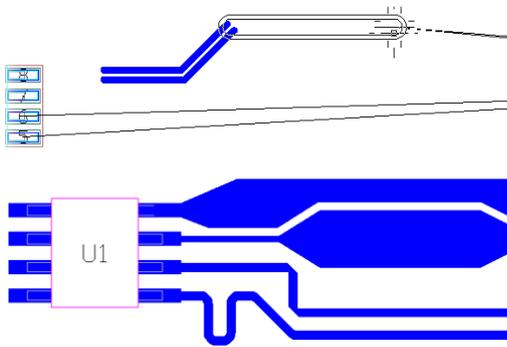


Библиотеки включают наборы параметризованных элементов, созданных с учетом требований стандартов IPC. Поддерживаются компоненты как для поверхностного монтажа, так и для монтажа в отверстия. Специальные модули дают возможность разрабатывать встроенные пассивные компоненты (конденсаторы, индуктивности, резисторы), а также параметризованные тонкопленочные и толстопленочные резисторы заданной мощности с возможностью последующей лазерной подгонки.

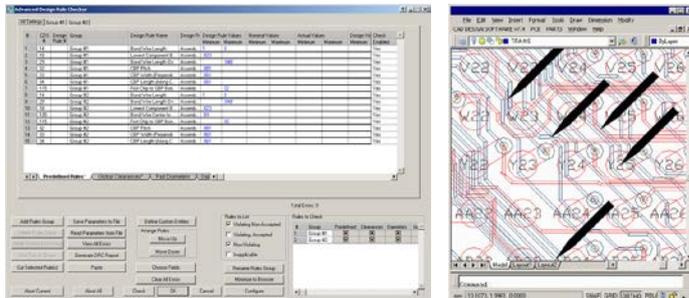
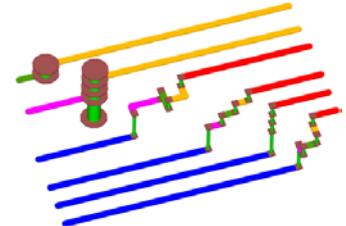




ООО "Евроинтех"
 140011, Россия, Московская обл.,
 г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
 Телефон: +7-(495)-749-45-78
 E-mail: sales@eurointech.ru
 http://www.eurointech.ru/cds

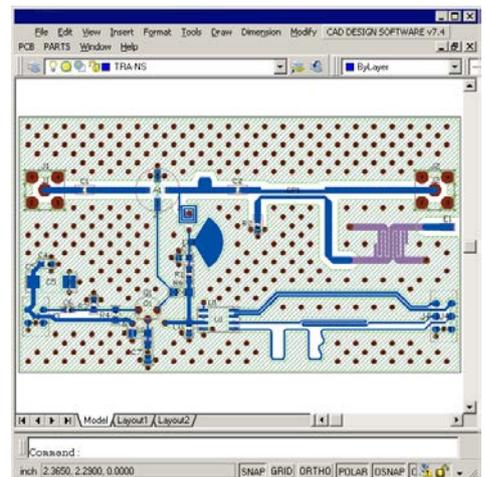
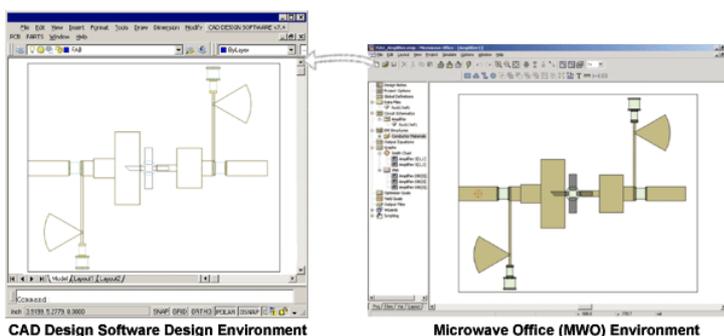


Прорисовка топологий может выполняться как на основе импортированного списка соединений, так и без него. Прокладка проводников выполняется с использованием интерактивного автотрассировщика, имеющего функцию расталкивания препятствий и поддерживающего сложные наборы правил по зазорам, в том числе и для дифференциальных пар.



Помимо стандартных наборов правил проектирования DRC (Design Rule Checking) могут быть заданы специальные LTCC и иные технологические правила. После завершения прорисовки топологии имеется возможность выполнить экстракцию внутреннего списка соединений и LVS проверку (Layout vs. Schematic).

Для оценки высокочастотных характеристик разработанной платы имеются интерфейсы обмена данными с популярными системами СВЧ моделирования: Agilent ADS, Ansoft HFSS, Sonnet, AWR Microwave Office, CST Microwave Studio.



Дополнительный САМ модуль выполнить следующие операции подготовки производства: поворот топологии на произвольный угол, независимое масштабирование по различным осям, зеркальное отображение, панелизацию, генерацию масок и управляющих файлов для оборудования сверления и пробивания отверстий, размещения компонентов, диспенсеров для нанесения клея и пасты, и установок разварки перемычек.

